

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2013年2月1日
【会社名】	株式会社日立製作所
【英訳名】	Hitachi, Ltd.
【代表者の役職氏名】	執行役社長 中西 宏明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【電話番号】	03-3258-1111
【事務連絡者氏名】	法務本部 部長代理 海保 太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【電話番号】	03-3258-1111
【事務連絡者氏名】	法務本部 部長代理 海保 太郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2013年2月1日の執行役社長の決定（取締役会から業務執行の決定を委任されている。）により、2013年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、株式会社日立プラントテクノロジー（以下「日立プラントテクノロジー」という。）を吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施することを決定し、吸収合併契約を締結したので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定により、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 吸収合併の相手会社についての事項

イ 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社日立プラントテクノロジー
本店の所在地	東京都豊島区東池袋四丁目5番2号
代表者の氏名	取締役社長 東原 敏昭
資本金の額	12,000百万円（2012年3月31日現在）
純資産の額	71,352百万円（2012年3月31日現在）
総資産の額	241,528百万円（2012年3月31日現在）
事業の内容	社会インフラシステム、産業システム、空調システム、エネルギーシステムに関する開発、設計、製造、販売、サービス、施工など

ロ 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

決算期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期
売上高（百万円）	281,148	246,269	271,649
営業利益（百万円）	2,921	2,028	7,805
経常利益（百万円）	2,528	2,130	7,749
当期純損益（百万円）	162	5,028	4,029

ハ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

株式会社日立製作所 100.00%

ニ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は、日立プラントテクノロジーの発行済株式のすべてを所有している。
人的関係	当社は、日立プラントテクノロジーに対して、取締役2名を派遣している。
取引関係	当社は、日立プラントテクノロジーとの間で、機器購入及び据付工事の発注などの取引等を行っている。

(2) 吸収合併の目的

当社のインフラシステム事業部門と日立プラントテクノロジーが統合することで、従来の社会インフラシステムの設計や開発、施工、保守などに加え、経営資産の管理やシステムのより効率的な運用に関するノウハウの提供まで含めたトータルソリューションの迅速な提供が可能となる。また、当社がグローバル

展開する社会イノベーション事業と日立プラントテクノロジーがグローバル展開するプラント一括ソリューション事業の一体運営をさらに進めることで、ソリューション提案力を強化し、今後需要の拡大が見込まれるITと融合された高度な社会インフラをはじめとする多様化したニーズへの対応力を強化していく。

(3) 吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容、その他の吸収合併契約の内容

イ 吸収合併の方法

当会社を存続会社とする吸収合併方式とし、日立プラントテクノロジーは解散する。

ロ 吸収合併に係る割当ての内容

当会社は日立プラントテクノロジーの発行済株式のすべてを所有しているため、本合併に際して、当会社の株式その他の財産等の割当ては行わない。

ハ その他の吸収合併契約の内容

当会社が2013年2月1日に締結した吸収合併契約の内容は、後記のとおりである。

(4) 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項なし。

(5) 吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社日立製作所
本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
代表者の氏名	執行役社長 中西 宏明
資本金の額	458,790百万円
純資産の額	現時点では確定していない。
総資産の額	現時点では確定していない。
事業の内容	情報・通信システム、電力システム及び社会・産業システムセグメントにおける製品の製造及び販売・サービス

(以下、吸収合併契約の内容)

吸収合併契約書

株式会社日立製作所(以下、「甲」という。)及び株式会社日立プラントテクノロジー(以下、「乙」という。)は、次のとおり吸収合併契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

第1条(合併の方法)

甲及び乙は、本契約の定めるところに従い、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として、合併する(以下、「本合併」という。)

第2条(商号及び住所)

甲及び乙の商号及び住所は、次の各号に定めるとおりである。

- (1) 甲：吸収合併存続会社
商号：株式会社日立製作所
住所：東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
- (2) 乙：吸収合併消滅会社
商号：株式会社日立プラントテクノロジー
住所：東京都豊島区東池袋四丁目5番2号

第3条（合併に際して交付する金銭等）

甲は、乙の発行済株式のすべてを所有しているため、本合併に際して、甲の株式その他の財産等の割当てを行わないものとする。

第4条（甲の資本金及び準備金の額）

本合併により甲の資本金及び準備金の額は増加しない。

第5条（株主総会）

本合併は、甲においては、会社法第796条第3項に定める簡易合併の規定により、乙においては、会社法第784条第1項に定める略式合併の規定により、それぞれ本契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものとする。

第6条（本合併の効力発生日）

本合併の効力発生日（以下、「効力発生日」という。）は、2013年4月1日とする。但し、手続の進行に
応じ必要あるときは、甲乙協議し合意の上、これを変更することができる。

第7条（会社財産の引継）

甲は、効力発生日において、乙の一切の資産、負債及びその他の権利義務を承継するものとする。

第8条（善管注意義務）

乙は、本契約締結後効力発生日に至るまでの間、善良なる管理者の注意をもって業務の執行及び財産の管理を行い、乙の資産、負債及びその他の権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲と協議し合意の上、これを実行する。

第9条（変更及び解除）

甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまでの間において、不可抗力その他の事由により、甲又は乙の財産状態若しくは経営状態に著しい変動を生じたときは、協議の上、本契約を変更又は解除することができる。

第10条（本契約の効力）

本契約は、以下の場合にはその効力を失う。

- (1) 効力発生日の前日（同日を含む。）までに前条に従い本契約が解除された場合。
- (2) 効力発生日の前日（同日を含む。）までに法令上本合併に関して要求される関係当局的の許認可等が得られない場合。

第11条（規定外事項）

本契約に定めるもののほか、合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に基づき甲乙協議の上、これを決定する。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

2013年2月1日

甲： 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
株式会社日立製作所
執行役社長 中西 宏明

乙： 東京都豊島区東池袋四丁目5番2号
株式会社日立プラントテクノロジー
取締役社長 東原 敏昭

以上